

特种环氧树脂芳烷基苯酚树脂PNH9780

产品名称	特种环氧树脂芳烷基苯酚树脂PNH9780
公司名称	湖南嘉盛德材料科技有限公司
价格	210.00/公斤
规格参数	牌号:PNH9780 产品等级:优 生产厂家:嘉盛德科技
公司地址	湖南省长沙市岳麓区麓谷大道627号新长海B3栋409
联系电话	0731-84123180 18273180586

产品详情

牌号	pnh9780	产品等级	优
生产厂家	嘉盛德科技	固体含量	100 (%)
粘度	见产品说明 (mpas)	用途	集成电路封装
cas	rohs		

芳烷基苯酚树脂

以苯酚和对苯二甲醇为单体、浓盐酸为催化剂,经friedel - c rafts烷基化反应合成了苯酚- 芳烷基型树脂

集成电路封装的目的之一是为集成电路芯片提供环境保护,使其免受或少受外界环境的影响,获得一个可以承受的工作环境,使集成电路能稳定、可靠地工作[1, 2]。但塑封集成电路的塑封体与其他材料一样,可从环境中吸收或吸附水气,特别是当集成电路处于潮湿环境时,可吸收或吸附较多的水气,且在塑封体表面形成一层水膜。若集成电路的塑封体与引线框架粘附不好,尤其是塑封体抗湿性不好,水气会沿着这些缺陷进入塑封体内部,甚至到达芯片表面,腐蚀芯片的铝金属化层,导致集成电路失效[3 ~ 6]。塑封体主要成分有环氧树脂、固化剂、填料和脱模剂等。其中,固化剂起交联的作用,它与环氧树脂一起影响塑封体的性能。传统的电子封装材料固化剂为线型酚醛树脂,由于线型酚醛树脂的结构中苯环的密度较大,使其具有坚硬、质脆的特点,当潮气进入塑封体时会引起塑封体开裂,影响电子产品的寿命。嘉盛德科技以苯酚和对苯二甲醇为单体、浓盐酸为催化剂,经friedel - c raf ts 烷基化反应合成了苯酚-芳烷基型树脂;利用傅里叶变换红外光谱(ftir)、核磁共振(¹³c nmr)、凝胶渗透色谱(gpc)等技术分别对产物的结构、相对分子质量及其分布进行了表征,并与线型酚醛树脂固化剂的性能进行了比较。